

tesa® HAF 8412

Informazioni Prodotto



Film strutturale di incollaggio conduttivo anisotropo ambrato da 50 µm

Descrizione prodotto

tesa HAF® 8412 è un film strutturale di incollaggio ambrato attivato dal calore, a base di resina fenolica e gomma nitrilica contenente particelle conduttive.

Caratteristiche

- Eccellenti prestazioni di messa a terra in applicazioni con requisiti di incollaggio strutturale
- Elevata forza di adesione in aree di incollaggio strette e di piccole dimensioni
- Buona resistenza all'invecchiamento
- Incollaggio affidabile del chip SmartCard e connettività elettrica in un unico passaggio
- Adatto per SmartCard (DI) in PVC, ABS e PC

Applicazione

tesa HAF® 8412 è progettato per l'incapsulamento di moduli chip in smart card a doppia interfaccia per applicazioni contactless e a contatto, nonché per applicazioni di messa a terra impegnative nell'elettronica di consumo.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-------|
| • Supporto | nessuno | • Spessore totale | 50 µm |
| • Massa adesiva | gomma nitrilica /
resina fenolica | • Colore | amber |
| • Tipo di liner | carta siliconata | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|---|---------------------|------------------------------|--------|
| • Potere di fissaggio (push-out) | 3 N/mm ² | • Temperatura di attivazione | 120 °C |
| • Resistenza di contatto direzione
z | 200 mOhm | | |

Info aggiionali

Raccomandazioni tecniche:

I seguenti valori sono raccomandazioni per i parametri macchina da cui iniziare. Si prega di notare che i parametri ottimali dipendono fortemente dal tipo di macchina, dai materiali specifici per i corpi carta e i moduli chip, nonché dai requisiti del cliente.

Incorporamento di moduli chip in smart card a doppia interfaccia

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=8412>

tesa[®] HAF 8412

Informazioni Prodotto

Info aggiuntive

1. Pre-laminazione:

Durante la pre-laminazione, il nastro adesivo viene laminato sul nastro dei moduli. La fase di pre-laminazione non influisce sulla durata di conservazione del nastro adesivo. I nastri dei moduli pre-laminati possono essere conservati per lo stesso periodo di tempo del nastro adesivo.

Impostazioni macchina:

Temperatura: 130–150 °C,

Pressione: 2–3 bar,

Velocità: 1,5–2,5 m/min

2. Incorporamento del modulo

Durante l'incorporamento del modulo, i moduli pre-laminati vengono fustellati dal nastro dei moduli, posizionati nella cavità della carta e incollati in modo permanente al corpo carta mediante calore e pressione. A seconda del tipo di linea di impianto, può essere utilizzato un processo a singolo passaggio o a più passaggi. Oggi, la maggior parte delle macchine di impianto prevede più fasi di pressatura a caldo.

Processo a singolo passaggio

Impostazioni macchina:

Temperatura¹: 180–220 °C,

Pressione: 80–130 N/modulo,

Tempo: 1,5 s

3. Processo a più passaggi (2 o più punzoni di riscaldamento)

Impostazioni macchina:

Temperatura¹: 180–220 °C,

Pressione 80–130 N/modulo,

Tempo: 2 x 0,7 s / 3 x 0,5 s

tesa[®] HAF 8412

Informazioni Prodotto

Info aggiuntive

¹Le raccomandazioni di temperatura si riferiscono a quanto può essere misurato all'interno del punzone di riscaldamento. Sono consigliate impostazioni di temperatura diverse per materiali carta diversi:

- PVC 180–190 °C
- ABS 180–190 °C
- PET 190–200 °C
- PC 200–220 °C

Applicazioni di messa a terra nell'elettronica di consumo

1. Pre-laminazione: durante la pre-laminazione, il nastro viene laminato su un componente.

Impostazioni macchina:

Temperatura¹: ≥120 °C,

Pressione²: ≥5 bar,

Tempo: ≥5 s

2. Incollaggio: rimuovere il liner dal nastro dopo la fase di pre-laminazione. Posizionare il componente pre-laminato sul substrato da incollare. Applicare una temperatura sufficiente, esercitando pressione per il tempo di incollaggio, per raggiungere una forza di adesione adeguata.

Impostazioni macchina:

Temperatura²: 120-250 °C,

Pressione³: 5-30 bar,

Tempo: 5 s – 3 min

² Le temperature di 'Pre-laminazione' e 'Incollaggio' si riferiscono ai dati misurati nella linea di incollaggio. ³ Le pressioni di 'Pre-laminazione' e 'Incollaggio' si riferiscono alla forza trasferita dalla superficie della dima direttamente all'area di incollaggio. I valori di forza di adesione sono stati ottenuti in condizioni standard di laboratorio. (Materiale: provino di prova in Al inciso / condizioni di incollaggio: temperatura = 180 °C; pressione = 10 bar; tempo = 7 sec). Per raggiungere la massima forza di adesione, le superfici devono essere pulite e asciutte.

tesa® HAF 8412

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=8412>